

エレクトロニクス 実装学会誌

第14卷第7号（通卷第97号）

2011年11月

ISSN 1343-9677

目次

■卷頭言—学会の会員動向に思うこと／東京理科大学 越地耕二

■特集／光インターフェースへの期待と展望

特集に寄せて／東北大学 杉原興浩	531
インターフェースにおける大容量・省電力化の進展と将来展望／日本電気 柳町成行, 須永和久	532
アクティブ光ケーブルによるボード間光インターフェース／古河電気工業 那須秀行, 瀬尾浩司	537
サーバ内における光配線／日本アイ・ビー・エム 平 洋一	542
光インターフェース用マルチモード導波路の目標仕様／日本オプテクスト 宮倉正人	547
ボード内配線実装技術に関する電気と光の比較／京都工芸繊維大学 裏 升吾	550

■研究論文

線路間結合を考慮した多ポートSパラメータを持った拡張OSE法によるプリント配線板の高周波特性解析 ／NEC 井上博文, 電気通信大学 本城和彦	555
--	-----

■技術報告

電解穴埋め銀めっきによるワイヤーグリッド偏光フィルムの作製 ／大阪府立大学 近藤和夫, 小山義則, 齊藤丈靖, 岡本尚樹	566
---	-----

■講座 TSV基礎講座 ④

TSV電極付チップの積層技術／長野県工科短期大学校 傅田精一	571
--------------------------------	-----

■研究室訪問

徳島文理大学理工学部電子情報工学科多田研究室／徳島文理大学 多田哲生	578
Vol. 14総目次 579	本会だより 583
会告 ①～④	

投稿論文募集中

「エレクトロニクス実装学会誌」では、投稿論文を受け付けております。詳しくは
Vol. 14 No. 2 (2011年3月号) 151~156ページ掲載の「投稿規程」「査読について」「原稿執筆の手引き」をご覧下さい。また、論文投稿に関して問い合わせ等ございましたら、Eメール (hensyu@jep.or.jp) までご連絡ください。

Journal of Japan Institute of Electronics Packaging

Vol. 14 No. 7

NOV. 2011

ISSN 1343-9677

CONTENTS

■Preface – Consideration of membership trend / Kohji KOSHII

■Special Articles / Optical Interconnection—Expectations and Prospects

Intention to the Special Edition / Okihiro SUGIHARA ————— 531

Recent Progress in High Speed and Low Power Interconnection Technology and Its Future Prospects

／ Shigeyuki YANAGIMACHI and Kazuhisa SUNAGA ————— 532

Board-to-Board Optical Interconnect Employing Active Optical Cables / Hideyuki NASU and Koji SEO ————— 537

Optical Interconnect in Server Systems / Yoichi TAIRA ————— 542

Target Specification of Multi-Mode Waveguide for Optical Interconnections / Masato SHISHIKURA ————— 547

Comparison between Electrical and Optical Intra-Board Interconnects and Packaging / Shogo URA ————— 550

■Technical Papers

A High-Frequency Analysis for the Printed-Circuit Board Using Enhanced Optimized Segment Extraction Method with Multi-Port S-Parameter Considering Coupling between Transmission Lines / Hiromi INOUE and Kazuhiko HONJO ————— 555

Fabrication of Wire Grid Polarized Film with Trench Fill Silver Electrodeposition

／ Kazuo KONDO, Yoshinori KOYAMA, Takeyasu SAITO, and Naoki OKAMOTO ————— 566

■Tutorial Series – The Basic Concept, Standard Structures and Fabrication Technologies of Through Silicon Vias ④

Stacking Technologies of Silicon Chips with Through Silicon Via Electrodes / Sei-ichi DENDA ————— 571

■Report – Tada Laboratory, Electronics Engineering and Information Science, Faculty of Science

and Engineering, Tokushima Bunri University / Tetsuo TADA ————— 578

News ————— 583 Announcement ————— ①～④

■会長 嶋田 勇三 ■副会長 越地 耕二 若林 信一

■編集委員会 委員長・安東 泰博 副委員長・高橋 康夫 末松 憲治 平 洋一 金谷 晴一

委員（五十音順）・赤星 晴夫 安食 弘二 伊藤 寿浩 碓氷 光男 榎 学 海老原理徳

折井 靖光 越地 耕二 小林 一治 澤田 廉士 白石 洋一 高原 秀行

塙田 裕 塙本 健人 箕輪 俊夫 山中 公博